

國立臺北科技大學九十五學年度碩士班招生考試

md2

系所組別：1201 製造科技研究所不分組

第二節 製造學（選考）試題

填准考證號碼

第一頁 共一頁

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**注意事項：**

1. 本試題共十題，每題 10 分，配分共 100 分。
2. 請標明大題、子題編號作答，不必抄題。
3. 全部答案均須在答案卷之答案欄內作答，否則不予計分。

1. 說明車床與銑床加工特性。10%
2. 為什麼會發生加工硬化？又如何處理加工硬化的問題？10%
3. 說明鋁合金之時效硬化的程序。及其各程序階段微結構之變化。10%
4. 說明塑膠射出加工，主要加熱機制為何？並說明塑膠種類。10%
5. 說明三次元量床〔CMM Coordinate Measuring Machines〕特性。其使用瓶頸為何？10%
6. 鍛造元件有何特性？何謂鍛流線？它對鍛件之影響？10%
7. 說明碳鋼拉伸試驗曲線如何？拉伸試驗曲線如何應用在板金加工？10%
8. 說明電弧焊接〔Arc welding〕原理。並說明母材的熱影響區〔heat affect zone〕。10%
9. 說明表面粘著技術〔SMT surface mount technology〕。SMT 常用之處？SMT 與那些材料關係密切？10%
10. 說明電子束加工〔EBM electron-beam machining〕原理及特性。10%